Rozdz.	Treść	Strona
10	Renowacja pustek pod płytkami i jastrychami	369

Soprodur® środek iniekcyjny do wypełniania pustek pod płytkami

Spotykanym zjawiskiem są odspojenia okładziny ceramicznej, kamiennej od jastrychu lub jastrychu czy zaprawy szpachlowej od podłoża.

Wymaga to podjęcia pracochłonnych działań naprawczych, które wiążą się z kompleksową renowacją. Jest ona kosztowna i zazwyczaj oznacza wyłączenie pomieszczeń z użytkowania.

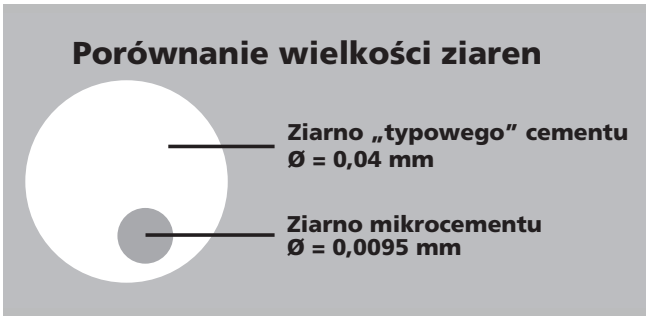
Alternatywę dla tego kosztownego i czasochłonnego rozwiązania stanowi naprawa posadzki przy użyciu środka iniekcyjnego Soprodur® 900.

Uszkodzenia zostają wówczas naprawione bez usuwania czy niszczenia okładziny.

Dzięki temu zyskujemy ogromną redukcję kosztów, a okładzina pozostaje optycznie nienaruszona.

Produkt do naprawy odspojonej okładziny lub jastrychu i wypełniania pustek musi mieć odpowiednio płynną konsystencję, dzięki czemu samoistnie lub pod niewielkim ciśnieniem, może być wprowadzony pod okładzinę lub jastrych, docierając do wypełnianej pustki lub wniknąć pomiędzy odspojoną okładzinę a podłoże. Dla sprawdzenia możliwości wnikania preparatu w danym zastosowaniu, można przeprowadzić iniekcję próbną.

Pustki pod okładziną ceramiczną.



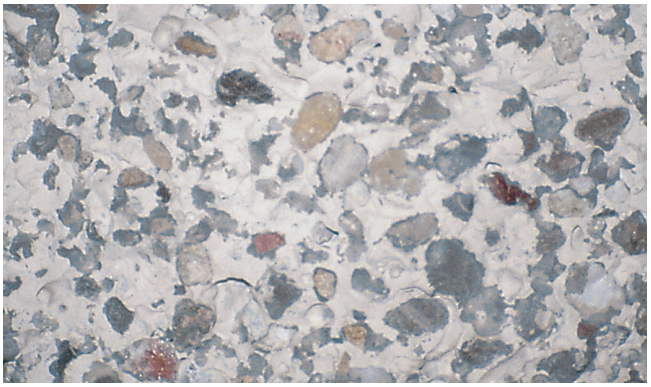
Wypełnianie pustek pod płytkami:

Zastosowanie cementowej zaprawy iniekcyjnej Soprodur® 900 wytworzonej na bazie mikrocementów, pozwala wypełnić pustki w zaprawie klejowej pod płytkami, drobne pęknięcia w zaprawie i pory w zaprawach grubowarstwowych, a także pustki w nieodpowiednio zagęszczonych jastrychach i posadzkach, wykonanych metodą wibrowania.

Zalety technologii Soprodur®:

- Uniknięcie kompleksowej renowacji posadzki
- Naprawiane powierzchnie można użytkować już następnego dnia
- Brak gruzu rozbiórkowego
- Brak konieczności wyłączenia z użytkowania całego pomieszczenia

Nieprawidłowo wykonany jastrych cementowy z otwartymi porami.



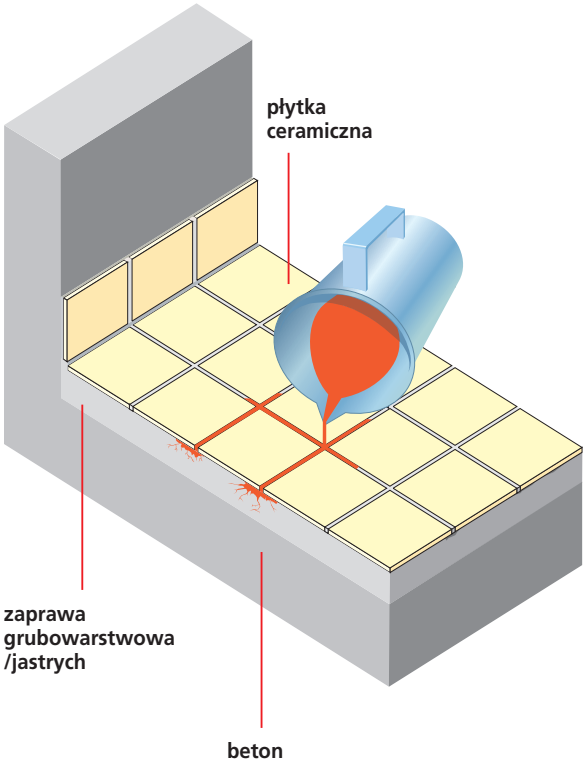
Spójna struktura jastrychu po zastosowaniu zaprawy iniekcyjnej Soprodur® 900.

Soprodur® środek iniekcyjny do wypełniania pustek pod płytkami

1. Metoda zalewania

Metoda zalewania jest najprostszym sposobem wypełniania pustek. Przygotowaną zaprawę wlewa się przez otwarte szczeliny fugowe w uprzednio nawilżone wodą pustki. Materiał aplikuje się do momentu ich całkowitego wypełnienia. Ewentualny nadmiar środka usuwa się na świeżo, wilgotną gąbką. Stężały materiał należy usunąć ze szczelin fugowych, aby następnie wypełnić je zaprawą fugową.

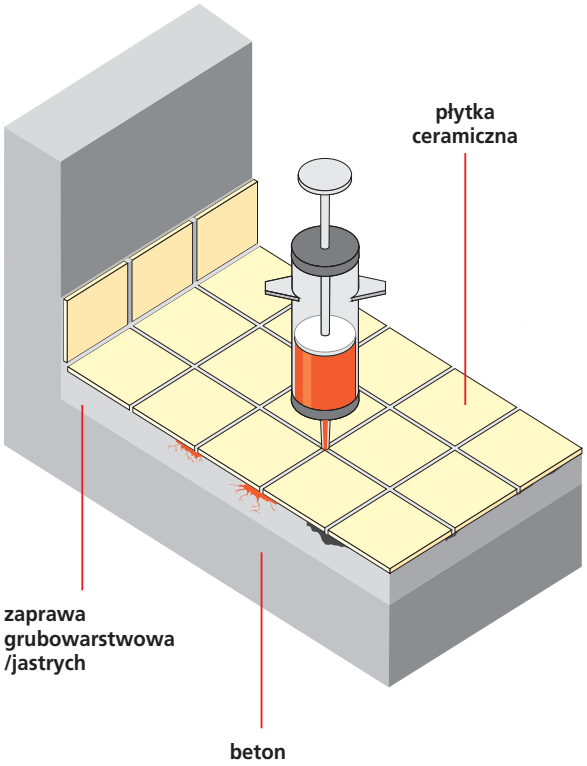
Zalewanie pustek podpłytkowych przez wyciętą w tym celu (otwartą) fugę.



2. Metoda wstrzykiwania

Płynną zaprawę iniekcyjną Soprodur® 900 można także aplikować, przy pomocy strzykawki ręcznej, przez otwarte szczeliny fugowe lub specjalnie nawiercone otwory. Przy użyciu odpowiednich strzykawek, pustki mogą być wypełniane pod ciśnieniem do 2 barów.

Aplikacja preparatu iniekcyjnego Soprodur® 900 za pomocą strzykawki ręcznej, uzasadniona jest na małych powierzchniach.



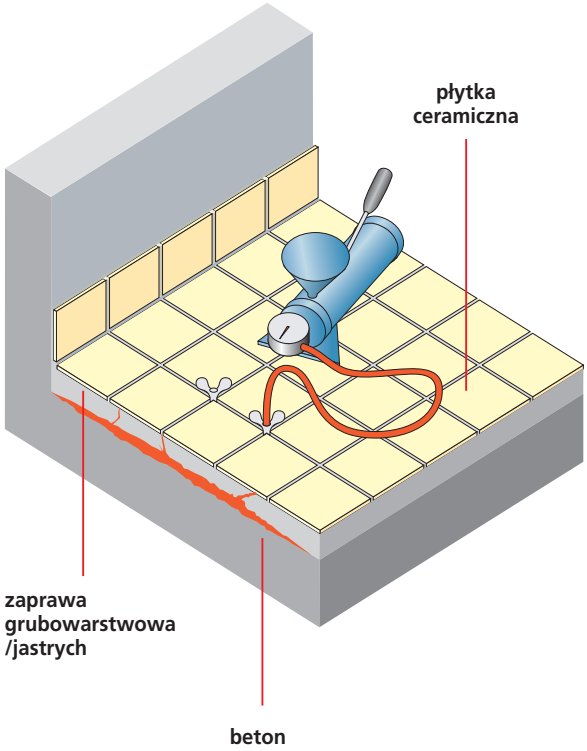
Soprodur® środek iniekcyjny do wypełniania pustek pod płytkami

3. Metoda iniekcji

Iniekcję preparatu Soprodur® 900 wykonuje się pod ciśnieniem do maks. 10 barów. Stosuje się przy tym dodatkowo specjalne elementy tzw. gniazda, wkręcane w nawiercone wcześniej otwory.

Liczba otworów iniekcyjnych i gniazd jest zależna od obszaru występujących pustek pod płytkami oraz stanu całego naprawianego układu konstrukcji (średnio ok. 1-5 otworów/m^2).

Iniekcja ciśnieniowa (do 10 barów).



Zastosowanie odpowiedniego gniazda

Do wypełniania pustek pod płytkami zalecamy stosowanie odpowiednich gniazd do płytek, które posiadają otwory w ściankach bocznych, umożliwiające iniekcję zaprawy Soprodur® 900 pod płytkę.

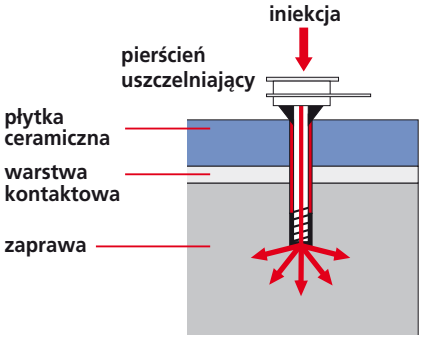
Do wypełniania pustek, powstałych przy zastosowaniu zapraw grubowarstwowych lub do wypełniania pustek pod jastrychami, należy zastosować gniazda do zapraw ze szczeliną iniekcyjną u dołu gniazda.

Do wkręconych gniazd podłącza się pompkę iniekcyjną i pod ciśnieniem do 10 barów wstrzykuje się zaprawę iniekcyjną Soprodur® 900, wypełniając pustki.

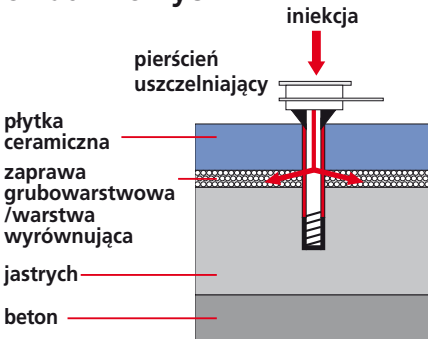
Przed iniekcją lub wstrzykiwaniem, pustki należy zwilżyć wodą za pomocą tej samej pompki.

Po wypełnieniu pustych przestrzeni, płytki należy obciążyć dla osiągnięcia optymalnej przyczepności (np. paczką z płytkami, workiem zaprawy), usunąć gniazda i powierzchnię oczyścić wodą.

Gniazda do zapraw



Gniazda do płytek okładzinowych



Wypełnianie pustek pod okładziną na schodach.

Soprodur® środek iniekcyjny do wypełniania pustek pod płytkami

Wskazówki

- Pustki należy wcześniej zlokalizować (np. opukując płytki) i odpowiednio oznaczyć.
- W przypadku jastrychów na warstwie oddzielającej, przy odpływach podłogowych itp. należy zwrócić uwagę i zadbać o to, aby zaprawa iniekcyjna nie dostała się tam, gdzie nie powinna, tzn. w warstwę izolacji termicznej, dylatacji brzegowych itp. Oznaką błędu będzie szybki i duży ubytek aplikowanego materiału.
- Przy ogrzewaniu podłogowym należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić przewodów grzewczych podczas nawiercania otworów pod następnie wkręcane gniazda.
- Preparat iniekcyjny Soprodur® 900 nie jest przeznaczony do podłoży wrażliwych na wilgoć (np. drewnianych).

Wypełnianie pustek pod płytkami na ścianach*

Pustki pod płytkami na ścianie mogą być również wypełniane i skutecznie naprawiane.

Soprodur® – narzędzia:

Zestaw do mieszania

Soprodur® 900 Środek iniekcyjny

Strzykawka ręczna, zestaw końcówek wtryskowych

Pompka iniekcyjna

Gniazda do płytek okładzinowych 6 mm

Gniazda do zapraw 6 i 8 mm

* Jeżeli planujemy wypełnić pustki pod płytkami na ścianach, po ich zlokalizowaniu warto zabezpieczyć płytki deskowaniem, na wypadek odsadzenia od ściany podczas iniekcji.